

半導体特殊ガスの削減装置

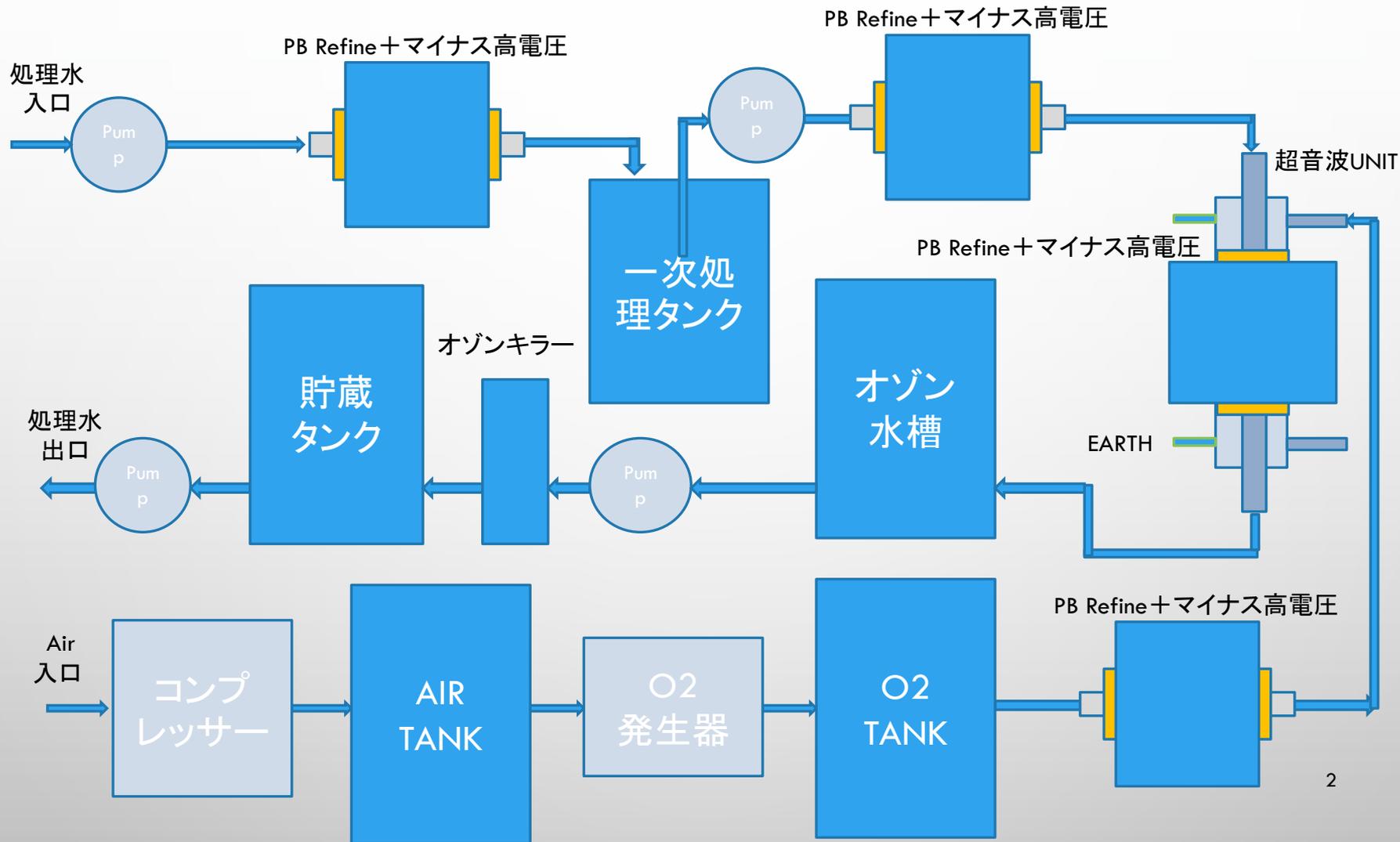


株式会社 リファインウェーブ科学技術研究所

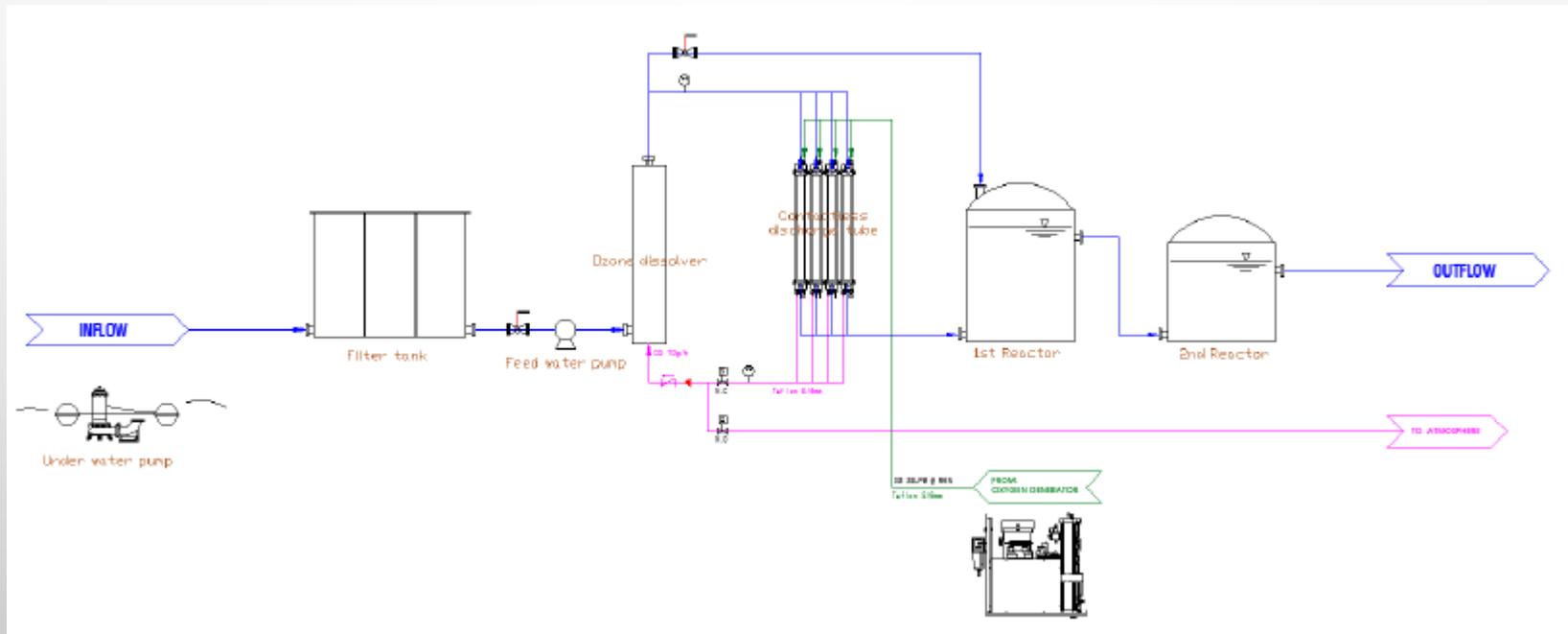
酸素ガス処理の特徴

- オゾン反応が高いため、脱色処理が可能
- 低価格
- 独自のミキサーと反応器を使用することにより、小型化を実現
- 既存設備に追加変更が可能

半導体特殊ガスの削減システム



簡略化したプロセス図



装置仕様

処理量	100t/day	個数
オゾン発生器 オゾン発生量 消費電力	500g/h 2. 2KW	1
酸素発生器 酸素発生量 消費電力	4. 4m ³ /h 80W	1
コンプレッサー 空気発生量 消費電力	78m ³ /h 12KW	1
ポンプ 処理流量 配管径(IN) 配管径(OUT) 消費電力	5m ³ /h 40A 15A 5. 5KW	3
反応槽	400L	4
貯蔵タンク	1, 200L	1
PB Refine+超音波UNIT 通水量 配管径(IN) 配管径(OUT)	70L/min 15A 15A	PB Refine: 4+ 超音波UNIT: 1
除鉄・除マンガン装置 通水量		1
オゾンキラー 通水量 消費電力		1
その他 流量計 フィルター(活性炭) フィルター		4 1 1
装置重量	約1, 500Kg	